

<報道資料>

※本資料は、2月6日(現地時間)に発表された英語版プレスリリースの抄訳です。

2017年2月7日

ウエスタンデジタル、世界初の512ギガビット 64層 3D NANDチップを発表 新開発のチップに関する論文をISSCCで発表

米国カリフォルニア州 International Solid State Circuits Conference (ISSCC)、2017年2月6日 — ウエスタンデジタルコーポレーション(NASDAQ:WDC、以下、ウエスタンデジタル)は本日、512ギガビット(Gb) 3ビットセル(X3)の64層 3D NAND(BiCS3)チップのパイロット生産を三重県四日市工場を開始したことを発表しました。2017年後半の量産を計画しています。本日のこの発表は、30年近くにわたりフラッシュメモリー業界をけん引してきたストレージ・リーダー企業であるウエスタンデジタルの最新の成果となります。

ウエスタンデジタルのメモリー技術担当エグゼクティブバイスプレジデント、シバ・シバラムは、次のように述べています。「業界初の512ギガビット 64層 3D NANDチップは、2016年7月に当社が発表した世界初の64層アーキテクチャーから集積度を2倍にしており、当社の3D NANDテクノロジーを前進させる重要なステップになります。本チップを、当社の3D NANDテクノロジーのポートフォリオに加えることにより、リテール、モバイル、データセンターアプリケーション等の幅広い用途における急速なデータの増大に伴うストレージ需要の拡大に引き続き対応することを可能とします」

512ギガビット 64層チップは、ウエスタンデジタルとテクノロジーおよび生産パートナーである株式会社東芝との共同開発になります。ウエスタンデジタルは、世界初の48層 3D NANDテクノロジーのパイロット生産を2015年に、そして世界初の64層 3D NANDテクノロジーのパイロット生産を2016年7月に発表しました。いずれの技術の製品も、引き続きリテールおよびOEM顧客に向けて出荷していきます。

ウエスタンデジタルは、このテクノロジーを実現した半導体集積回路の進化に関する技術論文を、2月7日にInternational Solid State Circuits Conference (ISSCC、半導体集積回路技術に関する国際会議)で発表する予定です。詳細は、<http://isscc.org/>をご覧ください。

■ウエスタンデジタルについて

ウエスタンデジタル(NASDAQ:WDC)は、データを作成、活用、体験、保存するためのストレージ技術やソリューションを提供する業界リーダーであり、お客様志向のイノベーションを取り入れた、高効率で柔軟性が高く、高速、高品質で魅力的なストレージソリューションを幅広く提供することによって、変化を続ける市場ニーズに対応しています。ウエスタンデジタルの製品は、HGST、サンディスク、およびWDのブランドでOEMや代理店、リセラー、クラウドインフラストラクチャ・プロバイダーに提供され、一般消費者向けにも販売されています。詳細については、www.hgst.com、www.wd.com、www.sandisk.comをご覧ください。

© 2017 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved.

Western Digitalは、米国およびその他の国におけるWestern Digital Corporation、またはその関連会社の登録商標または商標です。その他の商標も特定の目的のためにのみ使用されるものであり、各権利者によって商標登録されている可能性があります。

<本件に関する報道関係の方のお問い合わせ>

ウエスタンデジタル広報担当：鈴木

TEL: 0466-98-4044 FAX: 0466-98-3171

クレアブ株式会社

ウエスタンデジタル広報担当：石黒、渡辺、宮津

TEL: 03-5404-0640 FAX: 03-5404-7120

E-mail: WDCJapan@kreab.com